

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第7部門第2区分  
 【発行日】平成19年7月26日(2007.7.26)

【公開番号】特開2006-5086(P2006-5086A)  
 【公開日】平成18年1月5日(2006.1.5)  
 【年通号数】公開・登録公報2006-001  
 【出願番号】特願2004-178471(P2004-178471)

【国際特許分類】

**H 01 L 21/677 (2006.01)**

【F I】

H 01 L 21/68 A

【手続補正書】

【提出日】平成19年6月12日(2007.6.12)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

大気搬送室と、前記大気搬送室の一側に並列接続される真空気密可能な基板処理モジュールであって前記大気搬送室の一側に連通する前室及び該前室と連通する基板処理室から構成される複数の基板処理モジュールと、前記大気搬送室に備えられ大気搬送室を介して前記基板処理モジュール又は前記基板収納部に対して基板の搬送を行う1台の第1の基板搬送装置と、前記複数の基板処理モジュールを構成する複数の前室にそれぞれ備えられ、前室と基板処理室との間で基板を搬送する第2の基板搬送装置と、前記第1の基板搬送装置、第2の基板搬送装置、及び前記前室の圧力を制御する制御手段とを備えた半導体製造装置において、

前記制御手段は、

複数の基板処理モジュールの中で、基板処理室での処理が済んだ基板処理モジュールの該基板処理室から前記前室に処理済みの基板を搬送するよう前記第2の基板搬送装置を制御し、

前記処理済みの基板が前記前室に搬送されたことを検知すると、前記処理済みの基板が搬送された前室を真空圧から大気圧に復帰させるよう前記前室の圧力を制御するとともに、前記処理済み基板の搬送された前記基板処理モジュールに対して前記基板収納部から次の未処理基板の搬送を開始させるよう前記第1の基板搬送装置を制御するものであることを特徴とする半導体製造装置。